

2015年11月18日

各 位

J A三井リース株式会社

SEMICON Japan2015 出展のお知らせ

当社は半導体製造装置・材料の国際展示会である「SEMICON Japan2015」に出展しますので、下記の通りお知らせいたします。

記

日時	2015年12月16日(水)～18日(金) 各日 10:00-17:00
会場	東京都江東区有明 3-10-1 東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟 (当社出展ブース：2ホール 2532)
主催	SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)
公式サイト	<a href="http://www.semiconjapan.org/ja/">http://www.semiconjapan.org/ja/</a>

SEMICON Japan は今年で 39 回目の開催となる半導体製造装置・材料分野における世界最大級の総合イベントです。半導体関連デバイスの製造に関わる製品・技術・サービスの全てを網羅する国内唯一の国際展示会となります。

当社はこれまで国内外のお客様に対し数多くの大型ファイナンス案件を組成、半導体製造装置のリース・ファイナンス分野で世界有数の取組実績を有しております。また、2015年1月には米国中古半導体製造装置サプライヤーである AG Semiconductor Services, LLC(以下「AGSS」)へ出資をしました。SEMICON Japan2015 では、AGSS 社と共同でグローバルに展開するリース・ファイナンス事業、及び中古半導体製造装置売買事業をご紹介します(当社半導体製造装置分野の取組概要は[こちら](#)をご覧ください)。是非ご来場ください。

以 上

経営企画部 広報 I R 室 電話：03-3448-3520

【本件に関するお問い合わせ先】

グローバル営業本部 グローバルエレクトロニクス部  
(担当：熊澤、五木田 電話：03-3448-3850)